

Lundi 13	Mardi 14 juin	Mercredi 15 juin	Jeudi 16 juin	Vendredi 17 juin				
	8:30 – 10:00							
		8:30 – 10:00	8:30 – 10:00	8:30 – 10 :00				
	<p>8:30 – 9:00 Ouverture et présentation de l'atelier</p> <p>9:00- 10:00 Keynote PISTIS JC.Clément</p>	<p>Session 3 Ana. déf. des composants de puissance <i>D.Trémouilles S. Jouanole</i></p>	<p>Micro-atelier 1 Packaging, PCB Assemblages <i>V.Largeaud D.Lellouchi S.Heude-Verneyre</i></p>	<p>Session 8 Simulation et reproduction de défauts électriques (EOS, ESD, CEM) <i>T. Dubois JC.Clément</i></p>	<p>Micro-atelier 2 FIB <i>A.Garnier S.Lavagne</i></p>	<p>Tutoriel 6 Les techniques d'analyse de surface <i>Y.Depuyts</i></p>	<p>Micro-atelier 4 Préparation d'échantillons <i>V.Chazal C.Vacher C.Guerin</i></p>	
11h	10:15 – 12:15	10:30 – 12:00	10:30 – 12:00	10:15 – 12 :00				
Ouverture de l'accueil	<p>Tutoriel 3 Partie 1 Fabrication des composants (circuit intégré) <i>A.Garnier</i></p>	<p>Session 1 Connectique <i>C. Dall'Acqua Y. Munch</i></p>	<p>Session 4 Ana. déf. des VLSI <i>S.Lavagne G.Haller G.Bascoul</i></p>	<p>Micro-atelier 1 Packaging, PCB Assemblages <i>V.Largeaud D.Lellouchi S.Heude-Verneyre</i></p>	<p>Tutoriel 5 Techniques de localisation par moyens électro-optiques <i>G.Bascoul S. Dudit</i></p>	<p>Session 7 Caractérisations et défaillances vernis, potting et autres protections d'assemblages <i>Y.Mène D.Lellouchi T.Boutaric</i></p>	<p>Session 9 Défiabilisation des composants dans le process industriel <i>M.Gleizes J.Toulze D.Talbourdet</i></p>	<p>Micro-atelier 4 Préparation d'échantillons <i>V.Chazal C.Vacher C.Guerin</i></p>
12h00/14h00 Déjeuner	Déjeuner	Déjeuner	Déjeuner	12:00 – 12:30 : Bilan				
14h00-16h00	14:00 – 16:00	14:00 – 16:00	14:00 – 16:00	Déjeuner				
<p>Tutoriel 1 Systèmes de stockage d'énergie <i>JM Vinassa</i></p>	<p>Tutoriel 3 Partie 2 Fabrication des composants (assemblage) <i>A.Garnier</i></p>	<p>Session 2 Packaging ,PCB et Assemblages <i>C.Jephos F.Dulondel P.Retailleau</i></p>	<p>Tutoriel 4 Les fondamentaux de l'analyse de défaillance <i>G.Haller</i></p>	<p>Session 5 Passifs <i>F.Gonnet/J.Dhennin M.Gleizes</i></p>	<p>Tutoriel 5 Techniques de localisation de défauts par moyens électro-optiques <i>G.Bascoul S. Dudit</i></p>	<p>Session 6 Ana. déf. des composants optoélect. et hyperfréquences <i>G.Guibaud C.Vacher</i></p>	<p>14:00 : Départ</p> <p>ATELIER 2022 18^{ème} atelier ANADEF</p>	
16:30 – 18:00	16:30 – 18:00	16:30 – 18:00	16:30 – 18:00					
<p>Tutoriel 2 Les fondamentaux de la fiabilité pour l'électronique <i>H.Frémont</i></p>	<p>Open questions <i>A.Garnier</i></p>	<p>Session 2 Packaging ,PCB et Assemblages <i>C.Jephos F.Dulondel P.Retailleau</i></p>	<p>Open questions <i>G.Haller</i></p>	<p>Session 5 Passifs <i>F.Gonnet/J.Dhennin M.Gleizes</i></p>	<p>Open questions <i>G.Bascoul S. Dudit</i></p>	<p>Micro-atelier 3 Simulation et reproduction de défauts thermomécaniques <i>A.Guédon-Gracia J. Le Helloco</i></p>		
		Soirée fournisseurs						